

证券代码：688726

证券简称：拉普拉斯

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	长江证券、长江养老、初华资本、东方证券、国寿安保基金、国泰海通证券、海富通基金、华安证券、华能贵诚信托、华泰证券、华西基金、建信基金、江海证券、金信基金、景林资产、九益私募、开源证券、乐雪资本、美阳投资、民沣资产、茗晖资本、奶酪基金、申万菱信基金、SECF 基金、太平养老、西部利得基金、英大证券、钰锦投资、圆信永丰基金、浙商证券、中信证券、重阳投资、珠海德若等
时间	2025 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 11 日、11 月 13 日、11 月 18 日
地点	公司会议室、策略会会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 夏荣兵 投资者关系总监 关东奇来
投资者关系活动主要内容介绍	投资者问答： 1、公司下游市场需求和新签订单情况？ 答：公司如有重大合同或订单会根据相关规定及时披露，敬请关注公司公告。 未来设备市场需求主要包含具备技术竞争力的先进产能建设需求（尤其是 XBC 产能的建设）、存量产线技术升级需求（如

	TOPCon 和 XBC 存量产线的进一步技术升级和优化等)、海外扩产需求(如中东、北非、美国、东南亚等)等。 目前,光伏发电相较于传统能源发电已极具经济性,光伏行业装机需求的增长、光伏电池片技术的持续迭代都将为设备厂商带来更多的市场机会,光伏行业对满足新工艺、新技术的设备将产生持续需求。公司在 TOPCon、XBC 等新型高效光伏电池片核心工艺方面形成了竞争优势,同时与主流客户建立了良好的合作关系,并积极进行海外拓展,有利于提升公司经营能力、持续获得订单。 2、BC 电池设备与 TOPCon 有何差异?公司在 BC 电池设备领域的产业地位如何? 答:XBC 和 TOPCon 对部分设备的要求会有一定差异,例如:XBC 没有正表面栅线所以对色差要求更严格,对氮化硅层镀膜设备提出了更高要求;XBC 电池背面结构更加复杂、制备难度更高,因此对镀膜、扩散等设备也提出了更高的要求,其中 LPCVD 满足 XBC 电池片隧穿氧化层和掺杂多晶硅层的制备工艺需求,并凭借镀膜均匀性好、致密度高、产能大等优势成为 XBC 电池片隧穿氧化层和掺杂多晶硅层制备的主流技术选择。 凭借长期以来的聚焦和深耕,公司在高效光伏电池片设备领域形成了竞争优势,并与行业内下游多个主流电池片厂商形成良好的合作关系,其中包含目前 XBC 主要厂商隆基绿能、爱旭股份、平煤隆基、英发德睿等。 公司目前作为已量产 XBC 电池片产线的热制程、镀膜设备的核心供应商,获得下游主流客户的认可,也为我们在未来赢得更多订单奠定了基础。同时,我们深知行业竞争激烈,我们将持续提升产品的竞争力,不断创新,为客户提供更优质的解决方案,巩固并提升我们的市场地位。
--	--

3、关于 TOPCon 升级，我们目前设备进展情况如何？

答：光伏行业内企业积极推动技术创新和产能更新迭代，持续努力和探索 TOPCon、XBC 等技术的进一步升级迭代，Poly 层结构创新、半片/多分片、边缘钝化、硅片优化、栅线优化、减银或无银等新一轮技术探索持续推进。

在深入覆盖了 TOPCon、XBC 等技术路线的各类热制程、镀膜及配套自动化设备的基础上，公司在 EPD（边缘钝化）设备、激光 Poly 减薄设备等关键设备技术上取得良好进展。

公司开发适用于 TOPCon 电池边缘钝化的一体化设备解决方案，包含激光划片、半片钝化、半片检测等技术及设备，助力下游企业实现 TOPCon 产线的技术升级和电池量产效率提升。

公司创新研制了应用于 TOPCon 电池的激光 Poly 减薄设备，实现钝化结构图形化，在减少寄生吸收、提升双面率的同时保持表面钝化和接触电阻率的稳定性，实现整体最优的电池转换效率提升。

4、公司钙钛矿电池相关设备的技术路线及进展？

答：公司积极布局 TOPCon、XBC、HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备。在研项目包含“钙钛矿核心真空工艺设备的研发”项目等，合作研发项目包含“钙钛矿/晶硅两端叠层太阳能电池量产化制备技术及关键装备研发”等。

目前公司已有布局的钙钛矿电池相关设备包括 PVD、ALD、涂布等核心工艺设备，可满足钙钛矿电池多种不同技术路线的核心工艺需求，目前正在积极协助行业头部客户推动钙钛矿电池前沿技术的研发和验证。

由于研发阶段项目的未来应用和推广情况仍存在一定不确

	定性，公司将持续完善、丰富技术和产品，为下游客户提供更具性价比的核心工艺解决方案。 5、公司半导体设备相关布局进展如何？ 答：在半导体设备领域，公司积极开展分立器件和集成电路领域所需设备的开发，努力实现在集成电路领域的突破，服务下游客户技术升级需求。 在半导体分立器件设备领域，公司持续推动氧化、退火、镀膜设备等一系列半导体分立器件设备的开发与优化，获得了行业主流客户的 SiC 基半导体器件用超高温退火炉等核心工艺设备批量化订单。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单(如有)	无

风险提示：以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。